

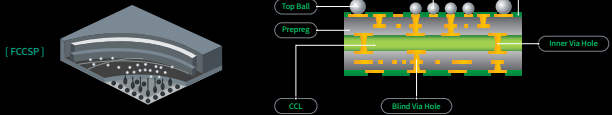
# BGA (FCCSP)

## 개요

## OVERVIEW

범프를 통해 반도체와 메인보드를 연결하는 패키지 기판

- 전기적 신호의 이동 경로가 짧고, 많은 수의 I/O 형성 가능
- 응용 분야 : AP (Application Processor), Modem 등



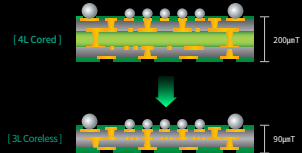
## 핵심 기술

## CORE TECHNOLOGY

박형 & 미세 회로 개발

- Fine Pitch Coreless 기판

- 회로 패턴이 절연재 안에 묻혀있는 형태의 회로 기판
- Coreless + 미세회로 형성으로 Layer 축소 설계 용이 (4L→3L)



## 주요 사양

## KEY SPECIFICATIONS

회로 (Line/Space)	7/8µm
Peripheral Bump Pitch	85µm
Bump Pitch	90µm
PPG 두께	18µm